



平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年11月6日

上場取引所 東

上場会社名 アピックヤマダ株式会社
コード番号 6300 URL <http://www.apicyamada.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 押森広仁

問合せ先責任者 (役職名) 取締役企画部長 (氏名) 小出 篤

TEL 026-275-2111

四半期報告書提出予定日 平成27年11月12日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年3月期第2四半期	4,131	△24.8	△438	—	△410	—	△405	—
27年3月期第2四半期	5,491	33.3	123	—	127	—	136	—

(注) 包括利益 28年3月期第2四半期 △401百万円 (—%) 27年3月期第2四半期 76百万円 (602.4%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
28年3月期第2四半期	△32.67	—
27年3月期第2四半期	10.98	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
28年3月期第2四半期	10,847	4,034	37.2	324.79
27年3月期	12,203	4,435	36.3	357.08

(参考) 自己資本 28年3月期第2四半期 4,034百万円 27年3月期 4,435百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
27年3月期	—	0.00	—	0.00	0.00
28年3月期	—	0.00	—	—	—
28年3月期(予想)	—	—	—	0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成28年3月期の連結業績予想(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	11,900	2.2	210	26.5	240	15.4	210	26.5	16.90

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
 - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
 - ③ 会計上の見積りの変更 : 無
 - ④ 修正再表示 : 無
- (注)詳細は、添付資料P. 3「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	28年3月期2Q	12,969,000 株	27年3月期	12,969,000 株
② 期末自己株式数	28年3月期2Q	548,200 株	27年3月期	546,184 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	28年3月期2Q	12,420,963 株	27年3月期2Q	12,423,345 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料P. 3「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

(四半期決算補足説明資料及び四半期決算説明会内容の入手方法)

当社は、平成27年11月27日(金)にアナリスト向け説明会を開催する予定です。
当日使用する決算説明会資料につきましては、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(セグメント情報等)	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間における世界経済は、米国では雇用や個人消費が底堅く景気は堅調に推移し、欧州経済は地政学的リスクがあるものの穏やかな回復基調で推移しました。一方、中国及び新興国においては、経済成長率の鈍化等により、先行き不透明な状況で推移しました。

また、我が国経済は、円安による企業業績の改善や設備投資の増加がみられるものの、個人消費の回復は依然弱く、横ばいの状況で推移しました。

当社の需要先である半導体業界においては、大手メーカーが2015年度の半導体設備投資計画を下方修正したことを皮切りに、設備投資に関しては一転慎重な見方が広まりました。一方、先端パッケージ分野に関しては先行投資を含め、引き続き前向きな動きが見られました。こうした環境の中で、当社グループはWLP（ウエハーレベルパッケージ）をはじめとする先端パッケージ分野及び車載向けパッケージ分野などに関して、積極的な技術開発と拡販活動を行いました。

この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は4,131百万円（前年同四半期比24.8%減）、営業損失は438百万円（前年同四半期は営業利益123百万円）、経常損失は410百万円（前年同四半期は経常利益127百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は405百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益136百万円）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

①電子部品組立装置

電子部品組立装置の受注環境につきましては、半導体後工程の新規パッケージ向け設備投資や電子部品向け装置が引き続き堅調な動きとなり、WLPやGTM-Xを中心としたモールド装置及びリード加工機が受注を牽引しました。一方、従来の顧客層と異なる受注が多く新規製作装置となり、想定より納期が延びたことにより、売上が計画を下回りました。このため、前年同四半期に比して利益面も圧迫しました。

この結果、売上高は2,873百万円（前年同四半期比20.3%減）、セグメント損失は13百万円（前年同四半期はセグメント利益は496百万円）となりました。

②電子部品

リードフレーム事業において、一部の製品で当社の外注加工費用を含む取引がありましたが、商流の変更により平成27年6月より外注加工費用を除く取引に変更となりました。なお、この変更により売上は300百万円程度減少しましたが、損益への影響は軽微であります。一方、売上が急増していたLEDブリモールド基板事業で、生産品種の入れ替えに伴う受注の減少が想定より長引いたこと等により、前年同四半期に比して売上が減少し、赤字幅が拡大しました。

この結果、売上高は885百万円（前年同四半期比43.0%減）、セグメント損失は144百万円（前年同四半期はセグメント損失108百万円）となりました。

③その他

その他につきましては、リード加工金型及びリードフレーム用生産金型の販売であります。リードフレーム用生産金型は低調な状況でしたが、リード加工金関連の投資需要が順調に推移いたしました。

この結果、売上高は372百万円（前年同四半期比11.9%増）、セグメント利益は39百万円（前年同四半期比40.3%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

(資産)

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、10,847百万円（前連結会計年度末は12,203百万円）となり、前連結会計年度末と比較して1,356百万円減少いたしました。これは主に、売掛金の減少によるものであります。

(負債)

当第2四半期連結会計期間末における負債合計は、6,813百万円（前連結会計年度末は7,767百万円）となり、前連結会計年度末と比較して954百万円減少いたしました。これは主に、支払手形、買掛金及び短期借入金の減少によるものであります。

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は、4,034百万円（前連結会計年度末は4,435百万円）となり、前連結会計年度末と比較して401百万円減少いたしました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上による利益剰余の赤字幅の拡大によるものであります。

なお、これらの要因により、自己資本比率は37.2%（前連結会計年度末は36.3%）となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比較して207百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には2,120百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、資金は65百万円の減少(前年同期間は828百万円の減少)となりました。これは主に売上債権が減少したものの、税金等調整前四半期純損失の計上、たな卸資産の増加及び仕入債務の減少によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果、資金は58百万円の増加(前年同期間は177百万円の減少)となりました。これは主に関係会社出資金の売却による収入によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、資金は217百万円の減少(前年同期間は215百万円の増加)となりました。これは主に短期借入金金の減少によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第2四半期連結累計期間につきましては、半導体部品組立製造装置においては、受注が計画を上回り推移しましたが、新規開発装置が多く想定より納期が延びた案件が発生したため、第2四半期累計期間の売上が計画を下回ること、また電子部品においてはLEDプリモールド基板事業で生産機種の入替えに伴う受注の減少が想定より長引いていること、以上を主な要因として売上、収益両面において計画を下回る見込みとなりました。このような状況を踏まえ、第2四半期累計期間の連結及び個別の業績予想の見直しを行い平成27年10月28日に第2四半期累計期間の業績予想の修正の公表をいたしました。

なお、通期業績予想につきましては、現状では受注が計画を上回って推移していることから、平成27年5月14日公表の通期業績予想は修正いたしません。今後の市況や業績動向等を踏まえ、修正が必要と判断した場合は速やかに開示いたします。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年9月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 平成25年9月13日）等を第1四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを行っております。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,328,689	2,120,851
受取手形及び売掛金	3,695,237	2,488,950
商品及び製品	299,769	461,830
仕掛品	1,826,401	2,076,687
原材料及び貯蔵品	145,190	170,835
その他	263,068	123,041
流動資産合計	8,558,356	7,442,197
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,009,142	978,042
機械装置及び運搬具(純額)	511,584	472,158
土地	511,589	511,589
その他	272,036	224,407
有形固定資産合計	2,304,352	2,186,198
無形固定資産	85,909	82,044
投資その他の資産		
その他	1,260,366	1,142,530
貸倒引当金	△5,160	△5,160
投資その他の資産合計	1,255,205	1,137,369
固定資産合計	3,645,467	3,405,612
資産合計	12,203,824	10,847,810
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,442,684	1,828,710
短期借入金	3,362,000	2,878,000
1年内返済予定の長期借入金	191,688	253,488
未払法人税等	26,543	17,187
賞与引当金	104,170	100,131
製品保証引当金	40,931	57,313
その他	410,977	308,214
流動負債合計	6,578,995	5,443,044
固定負債		
長期借入金	203,258	435,714
退職給付に係る負債	762,628	741,734
その他	222,945	193,124
固定負債合計	1,188,831	1,370,572
負債合計	7,767,826	6,813,617

(単位: 千円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,837,500	5,837,500
利益剰余金	△1,237,116	△1,642,873
自己株式	△100,434	△100,874
株主資本合計	4,499,948	4,093,752
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	32,068	22,500
為替換算調整勘定	△61,694	△52,689
退職給付に係る調整累計額	△34,324	△29,371
その他の包括利益累計額合計	△63,950	△59,559
純資産合計	4,435,997	4,034,192
負債純資産合計	12,203,824	10,847,810

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
売上高	5,491,384	4,131,573
売上原価	4,258,557	3,442,124
売上総利益	1,232,827	689,449
販売費及び一般管理費	1,109,006	1,128,259
営業利益又は営業損失(△)	123,821	△438,809
営業外収益		
受取利息及び配当金	2,204	2,608
為替差益	27,984	315
受取技術料	10,052	6,142
受取補償金	-	46,093
その他	40,234	25,119
営業外収益合計	80,475	80,280
営業外費用		
支払利息	35,370	37,132
持分法による投資損失	21,086	10,452
その他	20,312	4,851
営業外費用合計	76,769	52,437
経常利益又は経常損失(△)	127,527	△410,966
特別利益		
固定資産売却益	12,331	2,263
関係会社出資金売却益	-	10,422
特別利益合計	12,331	12,686
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	139,858	△398,280
法人税、住民税及び事業税	4,033	4,224
法人税等調整額	△620	3,251
法人税等合計	3,413	7,475
四半期純利益又は四半期純損失(△)	136,445	△405,756
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	136,445	△405,756

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	136,445	△405,756
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	7,597	△9,567
為替換算調整勘定	△37,992	25,773
退職給付に係る調整額	4,772	4,953
持分法適用会社に対する持分相当額	△34,002	△16,768
その他の包括利益合計	△59,624	4,390
四半期包括利益	76,821	△401,365
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	76,821	△401,365

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	139,858	△398,280
減価償却費	139,676	157,414
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△4,305	—
賞与引当金の増減額(△は減少)	25,562	△4,302
製品保証引当金の増減額(△は減少)	7,998	16,382
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△24,723	△15,938
受取利息及び受取配当金	△2,204	△2,608
支払利息	35,370	37,132
為替差損益(△は益)	△7,935	△15,530
持分法による投資損益(△は益)	21,086	10,452
固定資産売却損益(△は益)	△12,331	△2,263
固定資産除却損	184	4
関係会社出資金売却益	—	△10,422
売上債権の増減額(△は増加)	△868,683	1,211,568
たな卸資産の増減額(△は増加)	△887,682	△432,310
未収消費税等の増減額(△は増加)	△83,608	103,204
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△4,357	29,654
仕入債務の増減額(△は減少)	795,481	△609,510
その他の負債の増減額(△は減少)	△28,893	△81,172
小計	△759,507	△6,527
利息及び配当金の受取額	2,204	2,608
利息の支払額	△35,756	△37,159
法人税等の支払額	△35,880	△26,561
法人税等の還付額	251	2,637
営業活動によるキャッシュ・フロー	△828,687	△65,001
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△190,050	△34,816
有形固定資産の売却による収入	40,778	12,730
無形固定資産の取得による支出	△3,260	△3,472
関係会社出資金の売却による収入	—	81,187
その他の支出	△25,956	△1,143
その他の収入	518	4,158
投資活動によるキャッシュ・フロー	△177,969	58,642
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	340,000	△484,000
長期借入れによる収入	—	400,000
長期借入金の返済による支出	△106,344	△105,744
自己株式の取得による支出	△227	△439
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△17,653	△27,635
財務活動によるキャッシュ・フロー	215,775	△217,818
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4,399	16,339
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△795,281	△207,837
現金及び現金同等物の期首残高	2,907,376	2,328,689
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,112,094	2,120,851

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

「II 当第2四半期連結累計期間 4. 報告セグメントの変更等に関する事項」に記載のとおりであります。

(単位：千円)

	報告セグメント			合計
	電子部品 組立装置	電子部品	その他 (注)	
売上高				
外部顧客への売上高	3,605,122	1,553,151	333,110	5,491,384
セグメント間の内部売上高又は振替高	76,730	3,376	21,378	101,484
計	3,681,853	1,556,527	354,488	5,592,869
セグメント利益又は損失 (△)	496,110	△108,489	28,140	415,761

(注) 「その他」の区分は、リード加工金型及びリードフレーム生産用金型の調達・販売等を行っております。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容 (差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益	金額
報告セグメント計	415,761
セグメント間取引高消去	—
全社費用 (注)	△291,940
四半期連結損益計算書の営業利益	123,821

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第2四半期連結累計期間（自平成27年4月1日 至平成27年9月30日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント			合計
	電子部品 組立装置	電子部品	その他 (注)	
売上高				
外部顧客への売上高	2,873,461	885,345	372,767	4,131,573
セグメント間の内部売上高又は振替高	18,901	7,084	80,979	106,965
計	2,892,362	892,429	453,747	4,238,539
セグメント利益又は損失(△)	△13,716	△144,768	39,490	△118,995

(注)「その他」の区分は、リード加工金型及びリードフレーム生産用金型の調達・販売等を行っております。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

(単位：千円)

利益	金額
報告セグメント計	△118,995
セグメント間取引高消去	—
全社費用(注)	△319,814
四半期連結損益計算書の営業損失(△)	△438,809

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

4. 報告セグメントの変更等に関する事項

当社は、半導体製造装置、金型、リードフレーム及び各種電子部品等の製造販売を主要な事業としております。前連結会計年度から、「その他」について量的な重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。従って、当社はこれらを基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「電子部品組立装置事業」「電子部品事業」及び「その他事業」の3つを報告セグメントとしております。

「電子部品組立装置事業」は、モールドイング装置、リード加工機及びモールド金型等の製造・販売、「電子部品事業」は、リードフレーム及び電子通信部品等を製造・販売、及び「その他事業」は、リード加工金型及びリードフレーム生産用金型の調達・販売等であります。

なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第2四半期連結累計期間の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。